

臺灣高等法院民事判決

110年度上易字第109號

上訴人 視達威科技股份有限公司

法定代理人 吳振甫

訴訟代理人 任君逸律師

複代理人 陳又寧律師

蔡嘉晏律師

被上訴人 銀河製版印刷有限公司

法定代理人 李志峯

訴訟代理人 林明正律師

複代理人 朱峻賢律師

受告知人 柏承科技股份有限公司

法定代理人 李齊良

訴訟代理人 李訓萬

曾柏瑋

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國109年10月30日臺灣桃園地方法院106年度訴字第1690號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於110年10月27日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴及追加之訴均駁回。

第二審訴訟費用（含追加之訴部分）由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。

但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款定有明文。查上訴人於原審

主張其於民國104年11月12日向被上訴人購買採購單號「A000-000000000」、「品號「0-0000000000」、「品名「PCB IC502HD M/B Lay4, VOB」之電路板共計3,000片（下稱系爭電路板），嗣發現系爭電路板於上件組裝後有容易導通短路之瑕疵，爰依民法第227條第1項準用同法第226條第1項規定，請求被上訴人應賠償因不完全給付所生之損害，嗣於本院審理中追加依民法第227條第2項規定為請求權基礎（見本院卷第234、424頁），經核上訴人所為追加，與原起訴請求均本於兩造間系爭電路板買賣契約關係所生爭議之同一基礎事實，揆諸上開規定，並無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：伊於104年11月12日向被上訴人購買系爭電路板共計3,000片，而系爭電路板到貨後，伊先將其中800片送至打件廠即訴外人上尚科技股份有限公司（下稱上尚公司）打件，打件完成再送至組裝廠即訴外人宇宏科技有限公司（下稱宇宏公司）組裝，於測試時竟發現有無法電性導通、短路等現象，伊遂委託訴外人德凱宜特股份有限公司（下稱德凱宜特公司）檢測故障原因，結果為系爭電路板之焊墊與綠漆間有顆粒塞附、大面積或局部表面區域受鎳金元素覆蓋，致於零件上件後吃錫面積增加造成隔離區域間距縮短而易引起導通短路風險，該瑕疵顯然欠缺通常交易觀念所應具備之價值、效用品質，不符債之本旨而有給付不完全情事，經通知被上訴人處理均未獲置理。而伊係將系爭電路板中之800片交付打件、組裝後始發現上開瑕疵，致已打件、組裝完成之積體電路、電阻器、電容器等60種電子元件全部耗損列為廢品無法再使用，受有60種電子元件耗損材料費、打件費及燒錄費共新臺幣（下同）348,000元、宇宏公司檢測費用175,200元、德凱宜特公司鑑定測試費用15,500元、加計5%營業稅總計565,635元之固有損害，伊自得追加依民法第227條第2項規定請求被上訴人如數賠償；另系爭電路板中之2,000片於送廠打件、組裝完成前雖知悉上開瑕疵，然已於

01 產線上無法再行召回，僅能於產線上委請上尚公司、宇宏公
02 司進行拆卸、除錫、點焊等重工整修，應屬社會經驗上無法
03 補正之不完全給付，致伊受有支出重工整修費211,536元
04 （含稅）之損害，伊自得依民法第227條第1項準用同法第22
05 6條第1項規定，請求被上訴人如數賠償等語（未繫屬本院者
06 茲不贅述）。於原審本訴聲明：被上訴人應給付上訴人777,
07 171元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利
08 率5%計算之利息。另對於被上訴人之反訴，則略以：系爭電
09 路板存有前述之瑕疵，以伊本訴所主張之不完全給付損害賠
10 償債權，與被上訴人之反訴請求予以抵銷等語，資為抗辯。

11 【原審就本訴部分判決上訴人全部敗訴；就反訴部分則判決
12 上訴人應給付被上訴人464,966元，及自反訴起訴狀繕本送
13 達翌日即107年2月7日起至清償日止，按週年利率5%計算之
14 利息，並就判命上訴人給付部分，分別諭知准、免假執行之
15 宣告；另駁回被上訴人其餘之反訴（即駁回被上訴人請求上
16 訴人給付第一審律師費4萬元本息部分）。上訴人就其本、
17 反訴不利部分不服提起上訴，被上訴人則就其反訴敗訴部分
18 未聲明不服】。並於本院上訴聲明：(一)原判決關於1.駁回上
19 訴人後開第(二)項之訴部分；2.命上訴人給付464,966元本息
20 部分均廢棄；(二)上開廢棄1.部分，被上訴人應給付上訴人77
21 7,171元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年
22 利率5%計算之利息；(三)上開廢棄2.部分，被上訴人在第一審
23 之反訴及假執行之聲請均駁回。

24 二、被上訴人則以：兩造就系爭電路板之買賣僅簽署國內採購
25 單，並無其他契約明文，而採購單並無關於系爭電路板品質
26 要求之約定，上訴人所引用富士康集團SMT技術中心與其供
27 應商間之品質約定文件，不得作為本件之品質標準。而系爭
28 電路板係於104年12月7日即已交貨，惟原審送交財團法人臺
29 灣電子檢驗中心（下稱電子檢驗中心）鑑定之20片「空
30 板」，於鑑定人至上訴人處取樣時，其外包裝業已拆除，且
31 部分電路板另有標籤標示，無從確認鑑定標的之20片空板究

01 係伊交貨之原始空板，抑或上訴人重工整修後之空板；又鑑
02 定報告所稱之顆粒塞附情形，可能係上訴人拆除包裝以致影
03 響鑑定結果，亦可能係外包打件過程殘留錫渣所致，並非屬
04 伊交貨時即已存在之瑕疵；況鑑定報告就該20片空板測試後
05 並未發現有短路問題，至於塞附物容易引起導通短路之風險
06 一事僅為鑑定人片面推測而已，並非實測結果，不能證明系
07 爭電路板存有上訴人所指之瑕疵。且若系爭電路板確有瑕
08 疵，上訴人通知伊即得更換新品，並非無法補正之給付不能
09 情形，況上訴人並未證明其有60種電子元件耗損，亦未見打
10 件、燒錄工作之記載，更未說明清理多錫、重新點焊作業之
11 必要性，其主張之損害賠償項目均屬不實。若認上訴人對伊
12 確有損害賠償債權存在，伊爰以電路板買賣價金及賠償律師
13 費債權與上訴人之本訴請求予以抵銷等語，資為抗辯。另於
14 原審提起反訴，主張：上訴人於104年11、12月間分批向伊
15 採購如附件所示之各項電路板貨品，伊均已交付完畢，惟上
16 訴人迄今仍有貨款464,966元未付，伊自得依民法第367條規
17 定請求上訴人如數給付；又因上訴人遲延給付上開貨款，致
18 伊受有支出本件訴訟第一審律師服務費用4萬元之損害，伊
19 自得依民法第231條第1項規定請求上訴人如數賠償等語。於
20 原審反訴聲明：上訴人應給付被上訴人504,966元，及其中4
21 64,966元自反訴起訴狀繕本送達翌日起、其餘4萬元自反訴
22 追加狀繕本送達翌日起，均至清償日止，按週年利率5%計算
23 之利息。並於本院答辯聲明：上訴及追加之訴均駁回。

24 三、查上訴人於104年11、12月間以國內採購單，分批向被上訴
25 人購買如附件所示之各項電路板貨品，迄今尚有貨款464,96
26 6元未付；其中採購單號「A000-00000000」、「品號「0-0000
27 00000」、「品名「PCB IC502HD M/B Lay4, VOB」共計3,000片
28 之電路板，乃被上訴人委請受告知人即柏承科技股份有限公司
29 公司（下稱柏承公司）所製造，係於104年12月7日出貨交付予
30 上訴人收受等情，有採購單整理表、國內採購單等件影本在
31 卷可稽（見原審卷第8、157頁），上情復為兩造所不爭執

（見原審卷第281、282、285頁、本院卷第289頁），堪信屬實。

四、本訴部分得心證之理由：

上訴人主張伊向被上訴人購買系爭電路板共計3,000片，該等電路板之焊墊與綠漆間有顆粒塞附、大面積或局部表面區域受鎳金元素覆蓋，致在零件上件後吃錫面積增加造成隔離區域間距縮短而易引起導通短路風險之瑕疵，不符債之本旨而有給付不完全情事，依民法第227條第1項準用同法第226條第1項、第227條第2項之規定，請求被上訴人賠償瑕疵給付及加害給付之損害等情，為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯，經查：

(一)按物之出賣人就出賣標的物所負物之瑕疵擔保責任，以該瑕疵於「危險移轉時」存在者為限，此觀之民法第354條規定自明，倘瑕疵係於危險移轉後，因買受人或第三人之行為始行發生，外觀上即非出賣人應負物之瑕疵擔保責任範疇，亦非能解為可歸責於出賣人之事由所致之不合債之本旨之不完全給付。此時如買受人仍主張瑕疵係於危險移轉時即已存在，非嗣後買受人或第三人之行為所致，即應就此對其有利之瑕疵發生係與自己或第三人行為無關之特別情事負舉證責任，如不能舉證證明者，自不得主張出賣人應負物之瑕疵擔保責任或不完全給付之債務不履行損害賠償責任。

(二)查本件兩造均不爭執上訴人係於104年11月12日向被上訴人下單購買系爭電路板3,000片（見原審卷第157頁），被上訴人則於104年12月7日出貨交付系爭電路板予上訴人（見本院卷第289頁）。而上訴人進一步主張伊將其中800片轉交由訴外人上尚公司打件，打件完成再送至訴外人宇宏公司組裝，於測試時發現有無法電性導通、短路等現象等情，雖於原審提出德凱宜特公司出具之故障分析整合報告，其中記載：「失效描述：貫穿孔零件焊點間有短路現象」、「分析結果：表面OM分析：疑似有金屬顆粒塞附於綠漆與焊墊間；表面SEM/EDS分析：所有分析樣品皆發現綠漆與焊墊間有含鋁

金屬導體顆粒塞附的不良，此有可能增加焊墊與本該絕緣的鄰近金屬間，在焊接組裝前或後因電性間距縮小，而發生絕緣阻值異常的額外風險與機會」等語（見原審卷第9、10頁），惟上開報告僅為德凱宜特公司以光學顯微鏡、掃描電子顯微鏡等設備，觀察檢視上訴人自行送交之3片系爭電路板之外觀形貌所作之分析（見原審卷第10至29頁背面），其結論固為該3片電路板之綠漆與焊墊間存有鋁金屬導體顆粒塞附之現象，然上開報告並未說明發生顆粒塞附原因為何，亦未確認發生絕緣阻值異常等問題是否與第三人加工過程有關，或於排除第三人加工因素後，原始空板是否亦有短路問題等情，自不能以此逕認系爭電路板於危險負擔移轉時即存有上訴人所指之瑕疵而屬不完全給付。而被上訴人就此已抗辯異常原因恐係上訴人將系爭電路板交由上尚公司、宇宏公司打件、組裝等加工過程不當因素所造成，並提出柏承公司出具之零件板電性失效分析報告，結果為：「此次產品打件後因設計面導體間距5mil使用黑色油墨造成側露造成微短路非主要因素，打件後零件邊殘留錫渣為主因」等語（見原審卷第78頁）為憑，是上訴人既主張系爭電路板於第三人打件、組裝等加工處理後發現有顆粒塞附導致短路之異常現象，自應先行舉證證明此等瑕疵尚非與上尚公司、宇宏公司打件組裝等加工過程有關，如不能舉證證明，自不得對於被上訴人主張不完全給付之債務不履行責任。

(三)惟上訴人迄未舉證證明系爭電路板於打件、組裝後所發生之短路異常情形，應可排除加工過程因素所致，此觀兩造於原審皆同意送交電子檢驗中心鑑定，經該中心測試人員李穎弦於109年1月10日至上訴人處隨機抽取現場一批電路板中之20片「空板」帶回檢驗（見本院卷第350頁），並以光學顯微鏡檢查、進行SEM/EDX及導通電性檢測，結果為：「光學顯微鏡檢查：發現PCB樣品1~20的焊墊與綠漆之間均有顆粒塞附之現象」、「SEM/EDX檢測：主要塞附顆粒具有高含量的鋁、氧元素成分（重量百分比比例），推測此塞附物為氧化鋁

顆粒材質；PCB樣品發現多處顆粒塞附處均有顆粒大面積或局部表面區域受鎳金元素覆蓋，推估在進行鍍鎳、金製程前已有顆粒塞附的情況；其中樣品3、5、6、8~15、17~19可發現氧化鋁顆粒被大面積覆蓋化鎳金元素之情形；PCB樣品4發現塞附經偵測非高含量的鋁元素成分，顯示可能為雜質污染物顆粒；PCB樣品12發現塞附經偵測含有高含量的鋁、氧元素及鈦、氮元素成分，推測此塞附物為氧化鋁與鈦金屬或者是氮化鈦合成物所相結合的顆粒」，「導通電性檢測：進行導通電性檢測，針對顆粒塞附區域有化鎳金覆蓋之情形，在零件上件後致使吃錫面積增加造成隔離區域間距縮短，易引起增加導通短路之風險；此試驗經由採樣之空板區域檢測並無發現塞附之導通現象」等情（見外放鑑定報告書），且就各檢測位置區域所為導通電性檢測，結果亦均為：「未發現塞附所造成之導通」，有前揭鑑定報告書之導通電性檢測結果可查（見前揭鑑報告定書第207頁），可見上開抽樣之20片電路板「空板」焊墊與綠漆之間雖確有顆粒塞附，甚至有多處顆粒塞附處均有顆粒大面積或局部表面區域受鎳金元素覆蓋，惟並未發現有何因塞附之導通現象，亦即並無上訴人所稱之短路異常問題甚明；至於系爭電路板於打件、組裝後所發生之短路異常情形，是否能排除加工過程因素所致，則不在上開鑑定範圍內。從而系爭電路板於被上訴人交貨予上訴人，上訴人再轉交由第三人進行打件組裝等加工流程後，始發生短路異常等問題，上訴人既未證明系爭電路板於被上訴人交付時（危險負擔移轉時）即具有短路之瑕疵，自不得謂被上訴人之給付不合於債之本旨而有不完全給付情事，進而對被上訴人主張不完全給付之債務不履行損害賠償責任。

(四)上訴人雖以電子檢驗中心檢測人員李穎弦證稱：伊取回之20片電路板全部都是金色，沒有錫的顏色，錫的顏色是銀色為主，所以伊認為拿到的板子是空板等語（見本院卷第350頁），主張取樣之電路板即為被上訴人交貨之原始空板，而原始空板之隔離區存有氧化鋁塞附顆粒即屬瑕疵等情。惟李

01 穎弦亦證稱：伊看到的板子已經有鍍金，所以伊不能知悉先
02 前有無重工，伊沒有針對塞附顆粒是如何在板子上進行檢
03 測，也沒有去參與先前的製程，伊無從回答塞附顆粒的事情
04 是如何發生，測試報告只能看出有塞附顆粒的現象，並沒有
05 就塞附顆粒發生的原因作檢測等語（見本院卷第353、355
06 頁）；揆諸系爭電路板係於104年12月7日交貨，距離電子檢
07 驗中心抽樣之109年1月10日已時隔4年有餘，且被上訴人辯
08 稱抽樣當時之電路板外包裝均已拆除，並非其出貨時使用之
09 包裝態樣等情，亦有提出取樣當日電路板照片及出貨完整包
10 裝照片以資對照（見原審卷第257、258頁），而上訴人收貨
11 後既已將外包裝拆除，則鑑定人前往取樣之20片電路板究係
12 被上訴人交付之「原始空板」，或為被上訴人所辯係屬經過
13 打件再重工除錫之電路板，抑或有其他情形，自有所不明，
14 難以逕認鑑定人取樣時即為系爭電路板危險移轉交付時之狀
15 態。至於上訴人於原審固提出電子防潮箱照片（見原審卷第
16 263至266頁），表示系爭電路板均存放於防潮箱，且有作濕
17 度控制，並無事後保管方式不當等情，惟上開照片僅能證明
18 上訴人持有該等防潮箱之設備，尚不能證明上訴人自取得系
19 爭電路板至鑑定人現場取樣期間均將之存放於其內，況上訴
20 人既已將系爭電路板之外包裝拆除，即無從全然回復被上訴
21 人交貨時之原始樣貌，則事後檢測鑑定結果雖發現其上隔離
22 區有塞附顆粒之存在，然此乃檢測當時之電路板外觀情狀，
23 無法回推於被上訴人104年12月7日交貨時即已當然存在。

24 (五)上訴人再以李穎弦證稱：有塞附物導致隔離區變小，會影響
25 導通功能，也就是在電流量大時，因為隔離區不夠，而造成
26 短路的機會增大，電路板上件鍍錫後，如有塞附物是容易產
27 生短路…有顆粒塞附就有可能造成塞附區域被大面積覆蓋化
28 鎳金屬的風險，大面積覆蓋後就有增加導通短路的風險，這
29 是一連串增加風險等語（見本院卷第352、354、356頁），
30 主張本件雖未以打件後之電路板作導通電性測試，惟以證人
31 專業意見已可認為系爭電路板於放上電子零件後必有短路之

01 高風險等情。查上訴人於原審係表明「目前尚有200片尚未
02 進行加工，謹提出10組原板作為鑑定項目」（見原審卷第15
03 5、156頁），而被上訴人則認為舉證責任在上訴人，亦未要
04 求以打件後之電路板為鑑定標的（見原審卷第160頁），是
05 原審已依兩造聲請調查證據之全部內容囑託電子檢驗中心為
06 鑑定，並無遺漏；惟上訴人於本院自承：本件有無短路風險
07 與否，應以放上電子零件為前提，非以空板為前提等語（見
08 本院卷第382頁），然就此部分僅以「鑑定結論合理評估認
09 為打件後易引起導通短路」、「李穎弦證稱隔離區有氧化鋁
10 塞附物造成短路機會增大」等情為憑（見本院卷第383
11 頁），而就系爭電路板打件後是否仍存有導通短路問題，該
12 導通短路問題是否能排除打件組裝等加工因素乙節，不但欠
13 缺實際測試結果為佐，且李穎弦已證稱：因為原審法院囑託
14 鑑定函文上面的問題就是用空板詢問，所以會去抽選空板來
15 檢測…伊不知道上件的製程，所以關於容易引起導通增加短
16 路風險等都是假設問題而已等語（見本院卷第352、356頁
17 頁），揆諸系爭電路板於上件後會否短路之問題，於科學上
18 已有檢測方法，亦即可利用三用電錶，針對電路板有顆粒塞
19 附的區域與週邊焊墊進行導通性檢測（見外放鑑定報告書第
20 6頁），衡情該檢測方法並非現實上所難作，自不能逕以李
21 穎弦之經驗推測而取代實際測試之科學驗證結果，況系爭電
22 路板於上件後縱有短路之問題，是否能排除第三人加工因素
23 等情，亦未見上訴人舉證以實其說，則其依外放鑑定報告
24 書、李穎弦之證詞而指系爭電路板於交貨時即存有塞附顆
25 粒、增加導通短路的風險之瑕疵云云，自不足採。

26 (六)準此，依上訴人之主張，系爭電路板係被上訴人交貨後，上
27 訴人再轉交由第三人進行上件、組裝等加工後始發生異常情
28 形，而上訴人並未證明系爭電路板係於被上訴人交付時即具
29 有隔離區塞附顆粒之情事，亦未證明該塞附顆粒將導致電路
30 板上件組裝後會發生短路問題，更未舉證短路問題得以排除
31 係第三人加工過程所致，自不得主張被上訴人於危險負擔移

01 轉時有何未依債之本旨給付事實而應負不完全給付之債務不
02 履行責任，從而其依民法第227條第2項、第227條第1項準用
03 同法第226條第1項之規定，請求被上訴人應給付777,171
04 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%
05 計算之利息，為無理由，應予駁回。

06 五、反訴部分得心證之理由：

07 按稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產權於他方，他方支
08 付價金之契約；買受人對於出賣人，有交付約定價金及受領
09 標的物之義務，民法第345條第1項、第367條分別定有明
10 文。查上訴人於104年11月、12月間向被上訴人訂購如附件
11 所示之各項電路板貨品，貨款總計464,966元，惟迄今尚未
12 付款等情，為上訴人所不爭執（見原審卷第308頁），是被
13 上訴人反訴請求上訴人應如數給付上開貨款，並加計自反訴
14 起訴狀繕本送達翌日即107年2月7日（見原審卷第95頁）起
15 至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准
16 許。至於上訴人雖以其對被上訴人之不完全給付損害賠償債
17 權予以抵銷云云，惟上訴人之本訴主張業經本院認定為無理
18 由，已如前述，自無從抵銷，併此敘明。

19 六、綜上所陳，上訴人依民法第227條第1項準用同法第226條第1
20 項之規定，本訴請求被上訴人應給付777,171元本息，非屬
21 正當，不應准許；另被上訴人反訴依買賣契約之法律關係，
22 請求上訴人給付貨款464,966元本息，為有理由，應予准
23 許。從而原審就上開本訴不應准許部分及反訴應准許部分，
24 為上訴人不利之判決，於法並無不合，上訴意旨指摘原判決
25 此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。又
26 上訴人於本院追加依民法第227條第2項規定為請求權基礎部
27 分，亦無理由，應予駁回。

28 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證
29 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不
30 逐一論列，附此敘明。

31 八、據上論結，本件上訴及追加之訴均為無理由，依民事訴訟法

01 第449條第1項、第78條，判決如主文。
02 中 華 民 國 110 年 11 月 17 日
03 民事第十四庭
04 審判長法官 蔡和憲
05 法 官 陳 瑜
06 法 官 周珮琦
07 正本係照原本作成。
08 不得上訴。
09 中 華 民 國 110 年 11 月 17 日
10 書記官 強梅芳